



各 位

会 社 名 沖電気工業株式会社 代表者名 取締役社長 篠塚勝正 コード番号 6703 東証·大証第1部 問合せ先 IR室長 吉田 邦彦 電話番号 03-3501-3111(大代表)

ローム株式会社との半導体子会社株式の譲渡に関する契約書締結について

当社は、既にローム株式会社との間で基本合意に至っておりました、半導体子会社の株式譲渡に関しまして、正式契約を締結いたしました。本日開催の両社取締役会において決議し、正式契約を締結いたしましたのでお知らせ致します。

当該事象の損益及び連結損益に与える影響は、現在算定中であります。

なお、ローム株式会社との基本合意に関しましては、平成20年5月28日にお知らせいた しました「ローム株式会社と沖電気工業株式会社との間の半導体子会社株式の譲渡に関する基本合意について」をご参照下さい。

以上

<ご参考> (2008年5月28日 記者発表資料「ローム株式会社と沖電気工業株式会社との間の半導体子会社株式の譲渡に関する基本合意について」より)

1. 基本合意締結の理由

OKI では、グローバルな競争関係がより激化していく中で企業競争力を高め企業価値を拡大するため、全社を挙げて抜本的な経営改革を推し進めております。この一連の経営改革の中で、半導体事業の位置づけについても社内にて検討を進めて参りました。一方、ロームでは、競争優位性のある幅広い製品ポートフォリオを持った垂直統合型(IDM)半導体企業として発展することによる企業価値向上の機会を継続して検討してまいりました。

今回の合意は、こうした両社の状況を背景にして至ったものです。本件半導体事業は、ロームが取り扱う製品との重複が比較的少なく、相互補完による相乗効果を期待することが可能であり、ロームと本件半導体事業の双方の売上および収益性の一層の向上を期待できると考えています。

具体的には、本件半導体事業の強みである低消費電力技術・高耐圧技術・デジアナ混載技術・小型実装技術などを活かした競争優位性のある製品については、そのノウハウを長年にわたり蓄積してきた本件半導体事業のファブを最大限活用する一方、システム LSI・ロジック LSI をはじめ比較的新しい製品で外部のファンダリに依存しているものについては、ロームの最先端製造プロセスを活用するなどの施策を通じて、両者の強みを活かした積極的なシナジー効果が期待できると考えております。また販売面でも、両者の国内外の営業ネットワークや技術・品質サポートネットワークを最大限活用することにより、販売力の強化が可能であると考えています。

2. 譲受けの対象となる子会社(株式会社 OKI セミコンダクタ)の概要

(2)代 表 者 北林 宥憲(予定)

(3)所 在 地 東京都八王子市東浅川町 550 番地1 (予定)

(4) 設 立 年 月 日 平成 20 年 10 月 1 日 (予定)

(5)主な事業の内容 システム LSI、ロジック LSI、メモリ LSI、高速光通信用デ

バイスの製造・販売、ファンダリサービス (予定)

(6)決 算 期 3月31日(予定)

(7)従業員数連結:約6,000名(予定)

(8)主 な 事 業 所 本社・工場(宮城県、宮崎県、東京都、タイ王国)(予定)

(9)資本 金 20,000 百万円 (予定) (10)発行済株式総数 10,000 株 (予定)

(11) 大株主構成および所有割合 沖電気工業株式会社 100% (予定)

(12) 最近事業年度における業績の動向

平成 20 年 3 月期 連結売上高 141,559 百万円 連結営業利益 3,847 百万円 (OKI 半導体セグメント業績より)

3. 沖電気工業株式会社の概要

(1)商 号 沖電気工業株式会社

(2)代 表 者 篠塚 勝正

(3)本 店 所 在 地 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号

(4)主な事業の内容 情報通信システム、半導体、プリンタ事業における商品、技術および

ソリューションの提供

(5)ロームとの関係 人的および資本的関係はありません。

4. ローム株式会社の概要

(1)商 号 ローム株式会社

(2)代 表 者 佐藤 研一郎

(3)本 店 所 在 地 京都府京都市右京区西院溝崎町 21 番地

(4)主な事業の内容 LSI、トランジスタ、ダイオードなどの半導体及び電子部品の開発・

製造・販売

(5)OKIとの関係 ロームにとって、OKIは顧客に該当します。人的および資本的関係は

ありません。

5. 譲渡株式の対価等

ロームと **OKI** の間で合意した株式価値 900 億円 (株式 100%相当) を基礎とし、分割期日時 点において両社で別途合意した調整項目を加除して 95%相当の株式の譲渡価格を決定いたし ます。

6. 日程

平成 20 年 5 月 28 日 基本合意承認取締役会決議

平成 20年 5月 28日 基本合意の締結

平成 20 年 6 月 27 日 会社分割承認に係る株主総会決議 (OKI)

平成 20年 10月 1日 (予定) 分割期日及び株式譲渡期日

7. 今後の見通し

今後、事業内容の精査を行い、最終合意に向けて協議を進めてまいります。両社の連結業績 見通しについては、確定し次第公表の予定です。